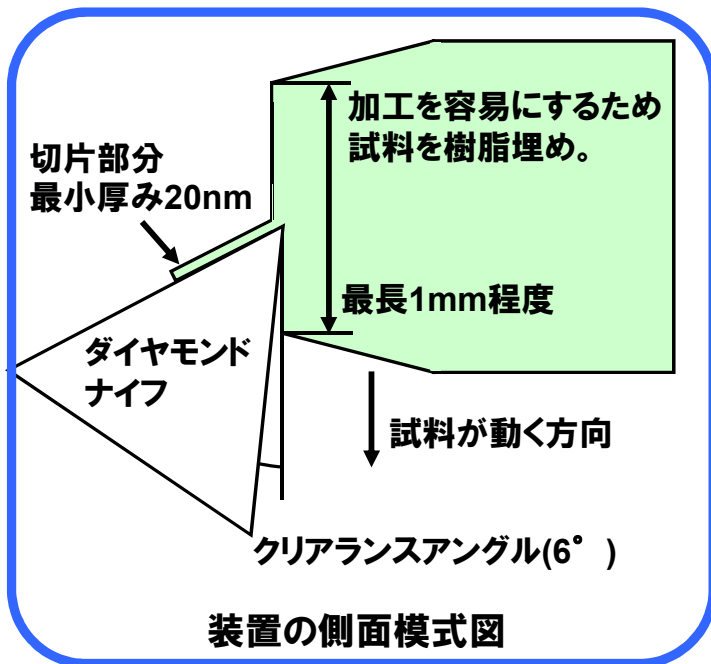


### ■原理

対象試料を樹脂に埋め込み、ダイヤモンドナイフを用い、【かな】の原理で切削することによって、試料の切片及び断面を作成する前処理装置である。

### ■装置概要



### ■対応可能材料

合成樹脂・金属材料  
一部複合材料(プリント基板等)

### ■試料制限

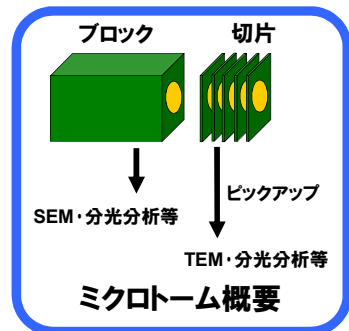
埋め込み可能な最大試料サイズ  
縦 x 横 x 厚み: 10mm x 5mm x 2mm  
最大加工範囲  
断面から見て縦 x 横: 0.3mm x 1mm  
不向きな試料: 伸縮するもの(ゴム等)や、硬いもの(セラミックス等)

### ■必要な情報

試料の構造・材料組成

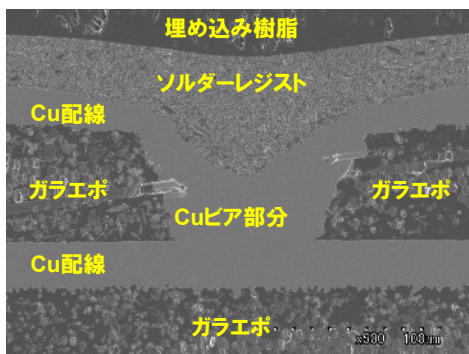
### ■特徴

- 100nm以下の超薄切片作成が可能。
- 水を使わないため、水の接触を嫌う試料前処理が可能。
- 熱を加えないので、高温に弱い試料を加工する際も影響が少ない。
- 応用できる分析手法が多い。(TEM、SEM、分光分析など)



### ■分析事例

プリント配線基板断面作成  
⇒ SEM観察



Snメッキ表面の凹凸を切削平滑化  
⇒ SEM観察・EBSD分析

